

# 合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参加 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）   |
| 来访单位名称        | 博时基金、长信基金、中泰电子  |
| 时间            | 2026年1月21日  |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强<br>证券事务代表：陈颖  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1. 问：公司可转换公司债券募投项目的整体规划？</b></p> <p>答：在显示驱动芯片封测领域，公司计划通过“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”的落地实施，提升显示驱动芯片铜镍金凸块的产能规模，同步扩大CP、COG、COF环节的产能供给。此举将进一步完善公司在显示驱动芯片封测业务的整体布局与产品矩阵，从而巩固在显示驱动芯片封测领域——尤其是铜镍金细分领域的市场领先地位；在非显示类芯片封测领域，公司依托在凸块制造、晶圆减薄等工艺的深厚积累，积极布局“FSM（正面金属化）+BGBM（背面减薄与金属化）+Cu Clip（铜片夹扣键合）”的先进封装组合，建立载板覆晶封装（FC）制程，优化公司产品布局，拓宽功率芯片应用领域，本次募投项目的实施将有利于提升公司非显示类封测业务全制程服务能力，带动现有制程的业务拓展。</p> <p><b>2. 问：公司非显示业务的主要客户？</b></p> <p>答：公司非显示业务的主要客户有南芯半导体、杰华特、纳芯微、矽力杰、思瑞浦、圣邦微、锐石创芯、昂瑞微、艾为电子、唯捷创芯等。</p> <p><b>3. 问：公司非显示类产品主要有哪些？</b></p> <p>答：公司的非显示主要以电源管理芯片、射频前端芯片（功率放大器、射频开关、低噪放等）为主，少部分为MCU（微控制单元）、MEMS（微机电系统）等其他类型芯片，可广泛用</p> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>于消费类电子、通讯、家电、工业控制等下游应用领域。</p> <p><b>4. 问：2025年第三季度，AMOLED的营收占比？</b><br/>答：2025年第三季度，AMOLED营收占比约17%。</p> <p><b>5. 问：公司2025年1-9月的折旧金额是多少？厂房的折旧年限？</b><br/>答：2025年1-9月合肥厂和苏州厂合计的折旧金额约为3.5亿元。公司苏州和合肥厂房的折旧年限都是20年。</p> <p><b>6. 问：公司目前订单能见度？</b><br/>答：目前公司客户一般约提供3个月的需求预测。</p> <p><b>7. 问：公司对外投资禾芯集成的情况介绍？</b><br/>答：为优化公司战略布局，拓展集成电路先进封装测试领域业务协同，公司拟以自有资金人民币5,000万元对禾芯集成进行增资。本次投资完成后，公司认缴禾芯集成新增注册资本2,600万元，增资完成后将持有其2.27%的股权，成为禾芯集成股东。</p> <p>公司作为国内集成电路高端封装测试领域的领军企业，参股专注于先进封测的禾芯集成，并非简单的资本布局，而是基于产业链协同的战略考虑。此次参股将从客户资源拓展、技术能力互补、先进封装生态完善三大维度，为公司构建了差异化竞争优势，进一步夯实在先进封测领域的行业地位。具体的内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于对外投资浙江禾芯集成电路有限公司的公告》（公告编号：2026-007）。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。  |
| 附件清单（如有）              | 无   |
| 日期                    | 2026年1月22日  |